

# Connect 8 V4.

## Technisches Datenblatt.

BERRY  ALLOC

01/2024

	Inhalt	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	Gewicht
1 Paket Connect 8 V4	9 Dielen	2,20 m <sup>2</sup>	23.71 ft <sup>2</sup>	15,7 kg
1 Palette Connect 8 V4	56 Pakete	123,34 m <sup>2</sup>	1327.61 ft <sup>2</sup>	891 kg

### Produktspezifikationen

Abmessungen	1288 x 190 mm
Gesamtdicke	8 mm
V-Fugen	4
Verriegelungssystem	DuoLoc
Gebrauchsklasse gemäß der europäischen Norm EN10874	23 intensive Nutzung im Wohnbereich
	32 mittlere gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	lebenslang
Garantie gewerbliche Nutzung	5 Jahre

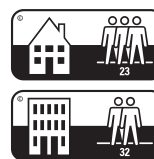
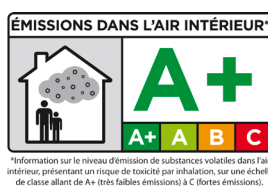
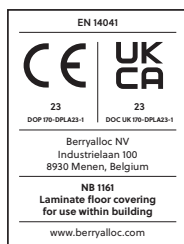
Garantiebedingungen auf [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### Aufbau

Oberschicht	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	feuchtigkeitsbeständige, hochverdichtete Faserplatte (HDF)
Gegenzug	direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier

### Testergebnisse

Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP $\geq$ 4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	kleine Kugel : $\geq$ 35 mm - große Kugel : $\geq$ 750 mm
Dickenquellung	ISO24336	12% (Anforderung $\leq$ 18%)
Feuerfestigkeit	EN13501-1	Cfl-S1
Formaldehydmission	EN717-1	E1
Rutschfestigkeit	EN13893	DS
Durchschnittsdichte	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppen 1+2) ; 4 (Gruppe 3)
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN16581	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine Schäden mit Rollen vom Typ W
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a>

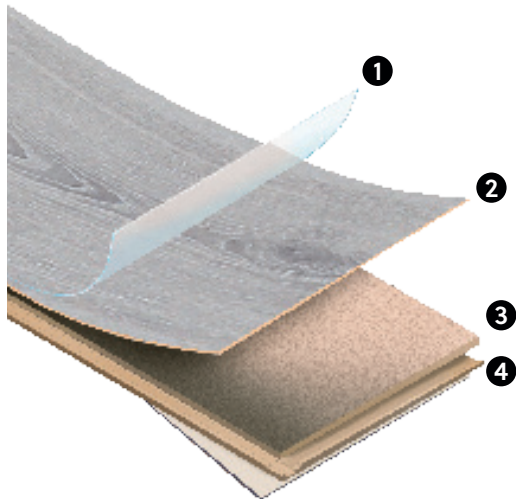


lamine.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

01/2024

### Woraus besteht ein Laminatboden?



- ① ein **Overlay**, das die Stärke und Beständigkeit Ihres Bodens bestimmt
- ② ein **Dekorpapier** für das Design
- ③ eine **hochverdichte Faserplatte** (HDF)
- ④ ein **Gegenzug** zur Stabilisierung und zum Schutz des HDF-Kerns